

## Publikationen

Günther Ruhl, T. Ullrich, Benedikt Winter, Raimund Förg, Alois Kasberger (2019): Entwicklung einer wasserdichten LED Flächenleuchte mit direkt im Glas eingebrachtem Konvertermaterial. Poster. In: DGaO Proceedings zur 120. Jahrestagung (11.-15.06.2019; Darmstadt).

T. Ullrich, Benedikt Winter, Stefan Menzel, Raimund Förg, Alois Kasberger: Precision Glass Molding of Light Emitting Optics, Containing Phosphors Directly Embossed into Glass. In: 6th Conference on Manufacturing, Tolerancing and Testing of Optical Systems, München.

Günther Ruhl, Stefan Menzel, Raimund Förg, Alois Kasberger: Development of a waterproof, high color fidelity LED Light Panel. In: 6th European Seminar on Precision Optics Manufacturing (POM19), Teisnach.

Günther Ruhl, Liane Bingel, Raimund Förg: Glas als Verpackungsmaterial für Lebensmittel. Posterpräsentation. In: 5. Tag der Forschung, Deggendorf.

Christian Wistl, Raimund Förg, Alois Kasberger: Precision glass molding - practical investigation in roughness transfer mechanism between mold and preform. In: 2nd European Seminar on Precision Optics Manufacturing, Teisnach.

Christian Wistl, Raimund Förg, Alois Kasberger: Investigation in roughness transfer between mold and preform during precision glass molding. In: 4th EOS Conference on Manufacturing and Testing of Optical Components (EOSMTOC 2015), München.

Christian Wistl, Raimund Förg, Alois Kasberger: "3D-Glas". 3D-Integration von Sensoren auf Glassubstraten. In: 2. Tag der Forschung 2015, Deggendorf.

Christian Wistl, Raimund Förg, Alois Kasberger: Präzisionsblankpressen, eine Verfahrensübersicht. In: 1. Tag der Forschung 2014, Deggendorf.

Raimund Förg: Thermoelektrischer Detektor zur Detektion von kontinuierlicher und gepulster Strahlung und Verfahren zur Herstellung/Thermoelectrical detector for detecting continuous, pulsed radiation, e.g. ....

Raimund Förg: Thermoelektrischer Detektor zur Detektion von kontinuierlicher und gepulster Strahlung und Verfahren zur Herstellung.

Raimund Förg: Integrierte Halbleiterschaltungsanordnung sowie Verfahren zu deren Herstellung/Semiconductor integrated circuit (IC) arrangement used in e.g. logic circuits, high-frequency (HF) amplifier circuits.

Raimund Förg: Capacitor device with a layer structure disposed in a meander-shaped.

Raimund Förg: Kondensatorbauelement mit einer mäanderförmig angeordneten Schichtstruktur.

Raimund Förg: Integrierte Halbleiterschaltungsanordnung sowie Verfahren zu deren Herstellung.

Raimund Förg: Semiconductor Device and Method for Producing the Same.

Raimund Förg: Method for Etching a Material Surface.

Raimund Förg: Method for producing a semiconductor including a material layer.

Raimund Förg: Verfahren zur Herstellung einer Materialschicht in einem Halbleiterkörper.

Raimund Förg: Method for producing material layer in semiconductor body.

Raimund Förg: Capacitor device with a layer structure disposed in a meander-shaped manner.



Raimund Förg: Halbleitervorrichtung und Verfahren zur Herstellung derselben.

Raimund Förg: Verfahren zum Herstellen eines Kondensatorbauelements.

Raimund Förg: Method for producing a semiconductor including a foreign material layer.

Raimund Förg: Method for Manufacturing a Composite Wafer Having a Graphite Core, and Composite Wafer Having a Graphite Core.

Raimund Förg: Method for Manufacturing a Composite Wafer Having a Graphite Core, and Composite Wafer Having a Graphite Core.

Raimund Förg: Ein Verfahren zum Herstellen eines Verbundwafer mit einem Graphitkern und ein Verbundwafer mit einem Graphitkern.

Raimund Förg: Composite wafer having graphite core and method for manufacturing same.

Raimund Förg: Method of etching a material surface.

Raimund Förg: Etching device and a method for etching a material of a workpiece.

Raimund Förg: Etching Device and a Method for Etching a Material of a Workpiece.

Raimund Förg: Manufacturing composite wafer, comprises depositing molding composition having carton powder and pitch on second side of semiconductor wafer and annealing deposited composition to form graphite.

Raimund Förg: Method for manufacturing a composite wafer having a graphite core, and composite wafer having a graphite core.

Raimund Förg: Ätzvorrichtung und Verfahren zum Ätzen eines Materials eines Werkstücks.

Raimund Förg: Procède de fabrication d'une tranche composite ayant un noyau de graphite, et tranche composite ayant un noyau de graphite.

Raimund Förg: Halbleitervorrichtung und Verfahren zur Herstellung derselben.

Raimund Förg: Method for Manufacturing a Composite Wafer Having a Graphite Core, and Composite Wafer Having a Graphite Core.

Raimund Förg: Method for manufacturing a composite wafer having a graphite core, and composite wafer having a graphite core.

Raimund Förg: Method for manufacturing a composite wafer having a graphite core, and composite wafer having a graphite core.

Raimund Förg: Electronic device and method for fabricating the same.

Raimund Förg: Electronic Device and Method for Fabricating an Electronic Device.

Raimund Förg: Elektronische Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer elektronischen Vorrichtung.

Raimund Förg: Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements oder eines Transistorbauelements mit einer dünnen Fremdmaterialschicht in einem Halbleiterkörper.

Raimund Förg: Electrical Contact for Graphene Part.

Raimund Förg: Electrical Contact for Graphene Part.

Raimund Förg: Elektrischer Kontakt für ein Graphenteil.

Raimund Förg: Composite Wafer Having A Graphite Core.



Raimund Förg: Semiconductor Device Having Solderable and Bondable Electrical Contact Pads.

Raimund Förg: Halbleitervorrichtung mit lotbaren und bondbaren elektrischen Kontaktplättchen.

Raimund Förg: Membrane structures for microelectromechanical pixel and display devices and systems, and methods for forming membrane structures and related devices.

Raimund Förg: Membranstrukturen für mikroelektromechanische Pixel- und Anzeigevorrichtungen und -systeme sowie Verfahren zur Ausbildung von Membranstrukturen und damit zusammenhängende Vorrichtungen.

Raimund Förg: Method for manufacturing a composite wafer having a graphite core, and composite wafer having a graphite core.

M. Nafria, Tobias Berthold, Günther Benstetter, R. Rodríguez, Raimund Förg, Werner Frammelsberger: Analysis of copper oxide films by combined scanning microscopy. In: 6th International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings (THINFILMS2012), Singapur, Singapur.